

## ORIENTAMENTO ALLA REWORK BGA (2 giorni)

### CODICE INTERNO

MTC-002B

### OBIETTIVI

Questo programma introduce alle tecniche approvate ed impiegate dalle aziende per la rilavorazione di moduli BGA. Il corso fa riferimento allo standard IPC 7711 (rilavorazione dei componenti).

### PRE-REQUISITI

Nessuno

### A CHI E' RIVOLTO

Personale addetto alle rilavorazioni di moduli BGA (Grid Array).

### DURATA

2 giorni

### PROGRAMMA / CONTENUTI

#### Giorno 1: Teoria

- Cenni sui processi di assemblatura di assemblati elettronici
- Tipi di componenti BGA
- Standard di riferimento
- Precauzioni ESD
- Precauzioni MSD
- Baking
- Valutazione giunti di saldatura BGA
- Metodologie di ispezione visiva e a raggi-X
- Attrezzature/Equipment
- Materiali chimici
- Metodologie di Rework BGA
- Preparazione delle piazzole
- Posizionamento termocoppie
- Profili di saldatura e dissaldatura
- Rischi di una cattiva rilavorazione
- Importanza delle calibrazioni e controlli periodici
- Test teorico

#### Giorno 2: Prove Pratiche

- Posizionamento termocoppie
- Profili di saldatura e dissaldatura
- Prove pratiche varie

### ESAME FINALE

Test teorico scritto; per superarlo con successo, il partecipante dovrà rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande.

## **ATTESTATO**

Attestato di partecipazione

## **NUMERO DI PARTECIPANTI**

Numero massimo di partecipanti alla sessione di teoria: 15 persone.

Numero massimo di partecipanti alla sessione di pratica: 5 persone.